

杭州士兰微电子股份有限公司

Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd

（浙江省杭州市黄姑山路4号）



2022年度向特定对象发行A股股票预案 (修订稿)

二〇二三年二月

发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第二次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年2月24日，公司召开第八届董事会第五次会议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》对预案进行调整，无需重新提交股东大会审议。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需上交所的批准以及中国证监会同意注册。

2、本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的决定后，按照法律法规及证监会等有关部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

如公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，即不超过283,214,369股（含283,214,369股），最终将以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。最终发行股份数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

6、本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过650,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产36万片12英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00
2	SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00
3	汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00
合计		1,005,000.00	650,000.00

本次向特定对象发行实际募集资金净额低于上述项目投资总额部分将由公司通过自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

7、本次向特定对象发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。

8、本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、公司实行连续、稳定的利润分配政策，并已建立起对投资者持续、稳定、

科学的回报机制。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，公司第七届董事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《股东分红三年（2021-2023）回报规划》。关于公司最近三年利润分配、现金分红政策及执行的详细情况等，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及相关情况的说明”。

10、本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，因此，公司的每股收益等指标短期内可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险。

虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。发行完成后，公司将在定期报告中持续披露填补回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

目 录

发行人声明	1
特别提示	2
目 录	5
释 义	7
第一节 本次向特定对象发行A股股票概要	9
一、发行人基本情况.....	9
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的.....	9
三、发行对象及其与公司的关系.....	14
四、本次向特定对象发行概要.....	14
五、本次发行是否构成关联交易.....	16
六、本次发行不会导致公司控制权发生变化.....	17
七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件.....	17
八、本次发行已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.....	18
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	19
一、本次募集资金使用计划.....	19
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....	19
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.....	29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	31
一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、 高管人员结构、业务结构的变化情况.....	31
二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	32
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况.....	33
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人 占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	33
五、本次发行对公司负债情况的影响.....	33
六、本次股票发行相关的风险说明.....	33

第四节 公司利润分配政策及相关情况的说明	37
一、利润分配政策.....	37
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况.....	39
三、未来股东回报规划.....	41
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	44
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明.....	44
二、本次发行摊薄即期回报的有关事项.....	44

释 义

本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、本公司、上市公司、士兰微、发行人	指	杭州士兰微电子股份有限公司
本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行	指	杭州士兰微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之行为
本预案	指	杭州士兰微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
发行基准日	指	发行期首日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
股东大会	指	杭州士兰微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州士兰微电子股份有限公司董事会
监事会	指	杭州士兰微电子股份有限公司监事会
公司章程	指	杭州士兰微电子股份有限公司章程
士兰控股	指	杭州士兰控股有限公司
士兰集昕	指	杭州士兰集昕微电子有限公司
士兰明镓	指	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司
成都士兰	指	成都士兰半导体制造有限公司
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
半导体	指	Semiconductor，是指常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料，常见的半导体材料有硅、砷化镓、氮化镓等
IDM	指	Integrated Design & Manufacture，设计与制造一体模式
集成电路、IC	指	Integrated Circuit，中文称作集成电路，是一种微型电子器件或部件，其采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。

传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
MEMS、微机电系统	指	微机电控制系统（Micro-Electro-Mechanical Systems）是集微型结构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，中文称作金属-氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，中文称作绝缘栅双极型晶体管，是由BJT（双极型三极管）和MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件
IPM	指	Intelligent Power Module，是一种先进的功率开关器件，兼具大功率晶体管和MOSFET的诸多优点
PIM	指	Power Integrated Module，功率集成模块，是将3相变频器电路、二极管桥接电路、制动电路集成到1个模块上的产品
SiC、碳化硅	指	Silicon Carbide，第三代半导体材料之一，主要应用为无线通讯器件、电力电子器件等领域

第一节 本次向特定对象发行A股股票概要

一、发行人基本情况

公司名称	杭州士兰微电子股份有限公司
英文名称	Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd
股票简称	士兰微
股票代码	600460
法定代表人	陈向东
注册资本	141,607.1845 万元人民币
成立日期	1997年9月25日
上市日期	2003年3月11日
股票上市地	上海证券交易所
统一社会信用代码	91330000253933976Q
注册地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号
邮政编码	310012
董事会秘书	陈越
电话	0571-88212980
传真	0571-88210763
电子邮箱	silan@silan.com.cn
公司网站	www.silan.com.cn
经营范围	电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。

二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、我国半导体行业面临良好的发展机遇

半导体集成电路是全球重点产业之一，是当今世界竞争最激烈、发展最迅速的领域，对世界经济的发展有着强有力的驱动作用，是21世纪信息社会高新技术产业的重要基础。

中国半导体行业经过三十多年的发展,经历了自主研发创业、引进提高和重点建设三个重要发展阶段。目前,中国半导体产业虽然已有一定的产业基础,但是在产品设计开发能力、生产技术水平、产品销售额和市场占比等方面,与经济发达国家相比仍有相当的距离,其中核心的关键产品仍以进口为主。面对国内外半导体广阔的市场需求和发展机遇,大力发展中国的半导体产业是国民经济信息化和实现中国国民经济第三步战略目标的迫切需要,也是增强中国在下一个世纪综合经济实力和竞争实力的必然要求。

我国“十四五”规划中,多个核心政策文件都将集成电路列入重点发展项目,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》专门列出了集成电路发展专项,体现了我国大力发展集成电路的决心。此外,国家层面频频出台有关半导体行业的支持政策:2021年3月,财政部、海关总署和税务总局联合发布的《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》,明确了涉及半导体免征进口关税的几种情况;2021年11月,工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》,提出加强半导体行业产业链协同创新;2021年12月,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,强调要抢先布局半导体前沿技术融合创新;2022年3月,发改委等联合发布《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》,进一步明确了对集成电路企业的税收优惠政策支持。

此外,中美关系的高度不确定性给中国企业半导体供应链的稳定性带来了巨大的挑战,半导体产业已成为当今大国博弈的主战场。出于维护供应链稳定的需要,半导体产业的国产替代已成为大势所趋,国内半导体企业势必将得到更多机会,得到国家政府更多直接、间接的扶持。

我国“十四五”规划将半导体和集成电路列为“事关国家安全和全局的基础核心领域”,集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发以及集成电路先进工艺、IGBT和MEMS等特色工艺突破都被予以重点关注。政策的强力支持将持续推动中国半导体产业的技术升级,推动一批有实力的国产厂商打破国际巨头的技术垄断,逐步推动半导体全产业链国产替代的进程。

2、12英寸晶圆芯片制造成为行业主流，我国已成为12英寸晶圆产能扩产中心

与国外先进企业相比，中国本土芯片制造企业产出规模相对较小，工艺水平相对落后，同时较多生产用的关键原辅材料、工艺设备等依赖进口，竞争力较弱。因此，国内芯片企业需积极发挥国内政策、资金、市场规模等优势，持续加大对技术、产品的研发投入，加强生产能力和产品品牌的建设，不断提升芯片产出规模和水平，逐步缩小与国际先进企业的差距。

在集成电路芯片制造领域，晶圆直径越大，每片晶圆能够生产的芯片数量就越多，采用大尺寸晶圆可以大幅增加产量，同时降低单颗芯片的成本。目前市场上的晶圆芯片制造以5、6、8、12英寸生产线为主，每次采用大尺寸晶圆取代原有产线，单位面积生产成本均可降低20%左右。相较于8英寸晶圆芯片制造，12英寸晶圆芯片制造在技术、成本和未来发展方面均有更大的优势。在技术方面，12英寸晶圆具有更小的工艺尺寸和更高的工艺集成度，能够突破8英寸工艺技术瓶颈；在成本方面，12英寸晶圆的晶圆面积是8英寸晶圆的2.25倍，单位面积集成芯片数量更多，拥有更低的制造成本。因此，12英寸晶圆芯片制造目前已成为行业发展主流。根据Semiconductor Engineering统计，2021年全球12英寸晶圆代工产能增长约10%，2022年预计达到11%，增速显著高于8英寸晶圆代工产能。

根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路制造业销售额已突破3,000亿元大关，中国已成为12英寸晶圆芯片制造的产能扩产中心。近年来，中国大陆本土晶圆制造业项目投资力度不断加大，发展速度不断加快，投产运营和在建的12英寸晶圆生产线数量不断增加。12英寸晶圆的扩产已成为行业主流，持续推动中国晶圆产能整体的迭代和升级。

3、受益于新能源汽车等下游应用领域高速发展，功率半导体市场空间广阔

功率芯片可以用来控制电路通断，从而实现电力变换。据Omda预计，2021年全球和中国功率半导体市场空间分别为462亿美元和182亿美元，至2025年有望分别达到548亿美元和195亿美元，2021年至2025年的复合增速分别为5.92%和4.55%。

2022年6月28日,在“2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会”主论坛上,工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东表示:“工业和信息化部将继续指导企业加大汽车芯片的技术攻关,推动汽车芯片生产线制造能力提升,指导车规级检测认证能力建设、加强优秀汽车芯片方案的推广应用,用好相关政策促进汽车芯片产品批量上车应用。同时,加大政策支持力度,发挥地方政府和行业龙头企业的关键作用,推动提升汽车芯片供给能力,特别是在新能源、智能网联、自动驾驶等领域抢抓机遇,聚力突破,支撑汽车产业高质量发展。”2021年全球各个国家推动新能源汽车的速度开始加快,根据IDC预测,受政策推动等因素的影响,中国新能源汽车市场2020年至2025年的年均复合增长率将达到36.1%,到2025年,中国新能源汽车销量将达到约542万辆。新能源汽车将新增大量与电池能源转换相关的功率半导体器件,新能源汽车终端市场的强劲需求,将带动整个功率半导体行业需求大幅度增长。

作为第三代半导体材料的典型代表,SiC具有宽禁带宽度,高击穿电场、高热导率、高电子饱和速率及更高的抗辐射能力,是高温、高压、大功率应用场合下极为理想的半导体材料。在新能源汽车领域,SiC功率半导体主要用于驱动和控制电机的逆变器、车载DC/DC转换器、车载充电器(OBC)等。车载充电器和充电桩使用SiC器件后将充分发挥高频、高温和高压三方面的优势,可实现充电系统高效化、小型化和高可靠性。据Yole预测,2025年全球SiC功率半导体市场规模将达到25.62亿美元,2019-2025年均复合增长率超过30%;其中新能源汽车市场(主逆变器+车载充电器+车载DC/DC转换器)规模占比最大,增速最快,2025年新能源汽车市场SiC功率半导体规模达到15.53亿美元,2019-2025年均复合增长率达到38%。随着新能源汽车及其充电系统的快速发展,SiC功率半导体市场空间广阔。

(二) 本次向特定对象发行股票的目的

1、积极布局和投入产线建设、持续巩固国内半导体IDM龙头企业优势地位、把握功率半导体领域发展机遇

公司经过二十多年的发展,坚持走“设计制造一体化”道路,打通了“芯片设计、芯片制造、芯片封装”全产业链,实现了“从5吋到12吋”的跨越,在

功率半导体（功率 IC、功率器件和功率模块）、MEMS 传感器、光电产品和高端 LED 芯片等领域构筑了核心竞争力,已成为目前国内最主要的半导体 IDM 企业之一。

本次向特定对象发行募集资金拟主要用于投资建设“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”、“SiC 功率器件生产线建设项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”。其中，“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”建成后将形成一条年产 36 万片 12 英寸功率芯片生产线,用于生产 FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET 功率芯片产品;“SiC 功率器件生产线建设项目”达产后将新增年产 14.4 万片 SiC-MOSFET/SBD 功率半导体器件芯片的生产能力;“汽车半导体封装项目（一期）”达产后将实现年产 720 万块汽车级功率模块的新增产能。

上述三个项目建设系公司在高端功率半导体领域的核心战略规划之一,是公司积极推进产品结构升级转型的重要举措。公司将充分利用自身在车规和工业级功率半导体器件与模块领域的技术优势和 IDM 模式下的长期积累,把握当前汽车和新能源产业快速发展的机遇,进一步加快产品结构调整步伐,抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口,扩大公司功率芯片产能规模、销售占比和成本优势,不断提升市场份额和盈利能力。该项目的顺利实施有助于提高公司对下游市场的供货保障能力和客户供应链安全性,持续巩固公司国内半导体 IDM 龙头企业优势地位,实现打造具有国际一流竞争力的综合性的半导体产品供应商的战略发展目标。

2、补充公司营运资金，满足业务持续发展需要

半导体行业属于典型的技术密集型和资本密集型行业。作为 IDM 企业,公司具有资产相对偏重的特征,为满足产业链中下游客户强劲的产品需求,保障公司的业务拓展、产品迭代和产线建设,公司需要持续的研发投入和大量的流动资金支持。通过本次向特定对象发行募集资金补充流动资金,一方面,可以满足公司业务持续发展需要,提升公司核心竞争力,巩固公司龙头地位;另一方面,可以缓解公司流动资金压力,优化公司资产负债结构,降低公司财务风险,提高公司资金使用的灵活性。

三、发行对象及其与公司的关系

本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会同意注册的文件后，按照相关规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

四、本次向特定对象发行概要

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在中国证监会同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

(四) 定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的决定后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

如公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。

(五) 发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，即不超过283,214,369股（含283,214,369股），最终将以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。最终发行股份数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

(六) 限售期

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七）上市地点

本次发行的股票将申请在上交所上市交易。

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行完成后，由公司新老股东按照发行后持股比例共同分享本次发行前滚存的未分配利润。

（九）本次发行决议的有效期限

本次向特定对象发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

（十）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过650,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产36万片12英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00
2	SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00
3	汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00
合计		1,005,000.00	650,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行募集资金投资项目中“年产36万片12英寸芯片生产线项目”拟通过

公司控股子公司士兰集昕具体实施,募集资金将通过公司向士兰集昕增资的方式投入。由于大基金持有公司5.82%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,大基金为公司的关联方;同时,大基金还直接持有士兰集昕7.82%(本次发行募集资金增资前比例)的股权,因此公司向士兰集昕增资构成上市公司的关联交易。

本次发行募集资金投资项目中“SiC功率器件生产线建设项目”拟通过公司参股子公司士兰明镓具体实施,募集资金将通过公司向士兰明镓增资的方式投入,本次增资后公司将取得士兰明镓的控制权。由于公司持有士兰明镓34.72%的股权(本次发行募集资金增资前比例),公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰明镓担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,士兰明镓为公司的关联法人,因此公司向士兰明镓增资构成上市公司的关联交易。

除上述情况外,本次发行不存在其他关联交易。

六、本次发行不会导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华7人直接持有公司3.47%股权,并通过公司控股股东士兰控股(陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华分别持有士兰控股17.40%、16.90%、16.90%、16.90%、16.90%、7.50%、7.50%股权)间接持有公司36.26%股权,陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华直接和通过士兰控股合计持有公司39.74%股权,为公司的实际控制人。

本次发行如按发行数量上限实施,本次发行完成后,公司实际控制人直接和通过士兰控股合计持有公司的股权比例下降至33.11%,但仍处于控股地位,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

本次发行的方案及相关事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过、2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年2月24日，公司召开第八届董事会第五次会议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》对预案进行修订，无需重新提交股东大会审议。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需上交所的批准以及中国证监会同意注册。在完成上述审批手续之后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部申请批准程序。公司向士兰明镓增资事宜，尚需履行国有企业增资相关审批程序。

上述呈报事项能否获得相关批准或同意注册，以及获得相关批准或同意注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 650,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产36万片12英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00
2	SiC功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00
3	汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00
	合计	1,005,000.00	650,000.00

本次发行实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目

1、项目概况

年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目系公司加快产能建设和产品技术升级、持续巩固国内半导体 IDM 龙头企业优势地位、把握功率半导体领域发展机遇、打造具有国际一流竞争力的综合性半导体产品供应商这一战略发展目标而计划实施的投资项目。

项目实施主体为公司控股子公司士兰集昕，募集资金将通过公司向士兰集昕增资的方式投入；项目建设地点为浙江省杭州钱塘新区（下沙）M6-19-3（东区 10 号路与 19 号路交叉口）地块。该项目将建设形成一条年产 36 万片 12 英寸功

率芯片生产线，用于生产 FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET 功率芯片产品；项目达产后，新增 FS-IGBT 功率芯片 12 万片/年、T-DPMOSFET 功率芯片 12 万片/年和 SGT-MOSFET 功率芯片 12 万片/年的生产能力。

2、项目实施的必要性

本项目实施的必要性具体详见本预案“第一节 本次向特定对象发行 A 股股票概要”之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”。

3、项目实施的可行性

(1) 项目符合国家集成电路、地方产业发展规划和产业政策

集成电路芯片制造产业作为一项战略性的产业，其技术水平和产业规模是衡量一个国家综合国力的重要标志之一。目前，中国大陆已成为全球 12 英寸晶圆扩产中心，相较于 8 英寸晶圆芯片制造，12 英寸晶圆芯片制造在技术、成本和未来发展方面有更大的优势，12 英寸晶圆的扩产已成为行业主流。同时，近年来“节能减排”、“开发绿色新能源”成为中国长期发展的重要战略，而功率芯片能够实现对电能的高效产生、传输、转换、存储和控制，提高能源利用效率，已成为推动国民经济可持续发展的基础。在国家绿色能源产业发展的推动下，功率半导体成为建设节约型社会、促进国民经济发展、践行创新驱动发展战略的重要支撑技术之一。发展功率半导体既符合国家发展战略，又符合市场发展需求，国家已出台一系列产业政策大力推进产业发展和相关领域的应用。

本项目建设地点位于浙江省杭州市钱塘新区（下沙），该项目高度契合浙江省和杭州市的产业发展规划和产业政策，因此项目落地和推进获得地方政府大力支持。本项目的建设与中国产业规划及产业结构调整指导目录等政策文件所制定的目标相一致，与地方政府政策一致，符合我国和地方产业政策的指导方向与发展要求。

(2) 功率半导体市场空间广阔，公司已具备良好的客户基础

功率芯片可以用来控制电路通断，从而实现电力变换。功率器件的市场空间具体详见本预案“第一节 本次向特定对象发行 A 股股票概要”之“二、本次向

特定对象发行股票的背景和目的”之“3、受益于新能源汽车等下游应用领域高速发展，功率半导体市场空间广阔”。

公司是国内半导体领域综合性的 IDM 龙头企业，以功率系统应用为核心进行功率器件、模块、电路等产品的布局，产品群丰富且产品性能、质量可靠，拥有成熟的销售网路，客户覆盖范围广泛。目前，本项目产品已在公司 8 英寸生产线上生产，公司已与多家国内外知名汽车企业建立了良好的合作关系。随着 12 英寸生产线产能的稳步释放，公司长期稳定且充沛的产能优势将进一步凸显。未来，公司将持续获取更多优质客户资源，为本项目的实施建设提供了坚定的客户基础。

（3）公司技术、知识产权和人才储备优势明显，为项目实施提供保障

公司作为国内半导体领域综合性的 IDM 龙头企业，注重研发的投入和技术的积累，现已拥有国内一流的设计研发团队和国家级博士后科研工作站。公司拥有集成电路芯片设计研发人员 500 余人，芯片工艺、封装技术、测试技术研发队伍等超过 2,200 人，研发队伍中拥有博士、硕士 450 余人；公司设有杭州、成都、无锡、西安等研发中心，以及化合物半导体技术研究院，陆续承担过国家科技重大专项、科技部“863”计划、杭州市重大科技创新专项等项目，具有丰富的项目管理经验。公司具有很强的集成电路芯片设计和工艺开发能力，拥有 5、6、8、12 英寸芯片生产线及封装测试生产线，构建了成熟的市场销售网络，能够为本项目实施提供技术、资金、市场等资源。此外，2021 年底公司参股子公司厦门士兰集科微电子有限公司 12 英寸芯片生产线已建成月产 12 英寸芯片 4 万片的生产能力，为本项目的顺利实施提供借鉴经验。

本项目实施主体士兰集昕具有集成电路芯片制造项目的建设、运营、管理经验，研发团队曾参与过多项国家科技重大专项、国家集成电路专项，以及省市科技重大专项，成果转化的基础工艺技术曾得到国家科技重大专项、国家集成电路专项资金、省市科技等项目支持，产品技术达到国内领先水平。公司投入生产以来不断开发新工艺、新技术、新产品，已经积累了丰富的技术开发经验，为本项目顺利实施提供了良好的技术支撑。

(4) 项目所在地浙江省杭州市在芯片设计及制造领域实力雄厚，为项目落地创造良好条件

经过多年潜心发展，浙江省已成为我国集成电路版图的重要组成部分。浙江省内已逐步形成以杭州、宁波为引领，嘉兴、绍兴和丽水等地协同发展的“两极多点”的产业发展格局。

经过多年深耕研发，杭州市在集成电路设计方面优势明显。自2018年起，杭州市集成电路设计产业销售规模一直稳居全国第四。除集成电路设计外，杭州在芯片制造领域的优势也在不断提升，目前已拥有多条芯片制造生产线，在特色工艺芯片制造、特殊工艺集成电路设计制造一体化等领域具有较强的优势与综合竞争力。

4、项目投资计划

本项目投资总额为人民币390,000万元，其中固定资产投资360,000万元，铺底流动资金30,000万元；拟投入募集资金300,000万元，全部用于固定资产投资，剩余部分由公司以自筹资金投入。

5、项目建设周期

本项目工程建设期3年。

6、项目预期经济效益

本项目预计内部收益率为10.38%（税后），静态投资回收期为6.67年（含建设期），具备较好的经济效益。

7、项目涉及的审批备案进度

本募集资金投资项目已完成项目备案并已获取环评批复。

(二) SiC功率器件生产线建设项目

1、项目概况

SiC功率器件生产线建设项目系公司加快产能建设和产品技术升级、持续巩固国内半导体IDM龙头企业优势地位、把握功率半导体领域发展机遇、打造具

有国际一流竞争力的综合性半导体产品供应商这一战略发展目标而计划实施的投资项目。

项目实施主体为公司的参股子公司士兰明镓,募集资金将通过公司向士兰明镓增资的方式投入,本次增资后公司将取得士兰明镓的控制权;项目建设地点为福建省厦门市海沧区兰英路99号。该项目在士兰明镓现有芯片生产线及配套设施的基础上,通过购置生产设备提升SiC功率器件芯片的产能,用于生产SiC MOSFET、SiC SBD芯片产品;项目达产后,将新增SiC MOSFET芯片12万片/年、SiC SBD芯片2.4万片/年的生产能力。

2、项目实施的必要性

本项目实施的必要性具体详见本预案“第一节 本次向特定对象发行A股股票概要”之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”。

3、项目实施的可行性

(1) 项目符合国家集成电路、地方产业发展规划和产业政策

本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展改革委2019年第29号令)第一类“鼓励类”项目。2020年7月27日,国务院发布了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号),该文件首次将“集成电路产业”放在首位,充分说明了国家对集成电路产业的重视程度。2020年11月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。该文件将化合物半导体归类为化合物集成电路。2021年6月,国家发改委等部委联合审核通过士兰明镓“集成电路线宽小于0.5微米(含)的化合物集成电路生产企业”认定,2022年再次通过认定。

本项目建设地点位于福建省厦门市海沧区,该项目高度契合福建省和厦门市的产业发展规划和产业政策,因此项目落地和推进获得地方政府大力支持。本项

目的建设与我国产业规划及产业结构调整指导目录等政策文件所制定的目标相一致，与地方政府政策一致，符合我国和地方产业政策的指导方向与发展要求。

(2) 功率半导体市场空间广阔，公司已具备良好的客户基础

功率芯片可以用来控制电路通断，从而实现电力变换。功率器件的市场空间具体详见本预案“第一节 本次向特定对象发行 A 股股票概要”之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”之“3、受益于新能源汽车等下游应用领域高速发展，功率半导体市场空间广阔”。

我国 SiC 等电力电子器件产品相关技术开发及产业化发展较晚，加之技术门槛高、投入大，现阶段 SiC 功率半导体器件的核心技术和产业几乎被欧美、日本 IDM 半导体厂商所垄断，国内前十大 SiC 功率半导体器件供应商均为国外企业。同时，SiC 等功率器件在汽车领域的应用非常广泛，加之国内“缺芯”状况非常突出，使得车用功率器件的进口替代空间巨大。基于 SiC 功率器件产品市场的增长、新能源汽车行业需求的增加以及“缺芯”问题的急迫性，加快功率器件产品的国产替代化已经成为行业共识。近几年，在国家政策的大力扶持下，国内企业加速引进和开发先进的设备、工艺技术，使得半导体功率器件芯片国产化出现了较大飞跃。在此背景下，SiC 功率器件生产线建设项目的实施符合国家政策导向，顺应市场趋势，与公司总体战略发展目标和公司现阶段实际情况相匹配。

公司 SiC 功率器件产品技术成熟，拥有良好市场基础。本项目 SiC 产品主要应用于新能源电动汽车电控模块，而公司功率芯片已经在乘用车电控模块中使用，因此将有助于 SiC 功率器件产品的推广应用。

(3) 公司技术、知识产权和人才储备优势明显，为项目实施提供保障

公司的技术、知识产权和人才储备具体详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”之“3、项目实施的可行性”之“（3）公司技术、知识产权和人才储备优势明显，为项目实施提供保障”。

2019 年起，随着 SiC MOSFET/SBD 芯片在新能源汽车电驱系统形成明确的应用，同时 SiC 功率器件在汽车应用领域得到持续推广，公司加快布局 SiC

MOSFET/SBD 芯片和功率模块的研发。本项目实施主体士兰明镓充分利用公司研发资源优势,以及6英寸芯片生产线技术和生产管理优势,突破并掌握了平面栅 SiC MOSFET/SBD 关键技术。

本项目依托公司强大的设计能力和芯片制造能力,以及公司运行多年的芯片生产线的管理经验,将进一步扩大产品产能,提升产品质量,深度开发 SiC MOSFET/SBD 芯片,充分发挥公司的技术优势,实现公司产品向高端产品领域的扩展,有助于加快我国功率模块生产技术进步,提升行业发展水平。

(4) 项目所在地福建省厦门市具有半导体产业聚集规模,为项目落地创造良好条件

项目所在地福建省已有许多集成电路芯片设计、制造、封装、材料等企业,形成了一定的产业聚集规模。厦门市是福建省芯片产业聚集区,已建设火炬高新区、海沧台商投资区、自贸区湖里片区三个集成电路重点集聚区域。

目前,厦门已获批建设“芯火”双创基地(平台)、设立海峡两岸集成电路产业合作试验区。同时,为鼓励集成电路产业发展,厦门市还针对集成电路产业出台了相关规划、实施细则、投融资、人才支持和科研支持等众多政策,进一步推动项目建设,提升高速芯片、高功率芯片、5G 射频芯片和 5G 功放芯片等制造工艺水平。《厦门市集成电路产业发展规划纲要》提到,到 2025 年,集成电路产业产值将达到 1,500 亿元,以集成电路产业支撑的信息技术产业和相关产业规模超 4,500 亿元,成为我国集成电路产业发展的重点集聚地区之一,形成具有国内龙头地位的化合物半导体研发、产业化基地,构建较为完整的产业链,在部分领域占有国际半导体产业版图中的一席之地。

4、项目投资计划

本项目投资总额为人民币 150,000 万元,其中固定资产投资 140,000 万元,铺底流动资金 10,000 万元;拟投入募集资金 75,000 万元,全部用于固定资产投资,剩余部分由公司自筹资金投入。

5、项目建设周期

本项目工程建设期 3 年。

6、项目预期经济效益

本项目预计内部收益率为 25.80%（税后），静态投资回收期为 5.80 年（含建设期），具备较好的经济效益。

7、项目涉及的审批备案进度

本募集资金投资项目已完成项目备案并已获取环评批复。

（三）汽车半导体封装项目（一期）

1、项目概况

汽车半导体封装项目（一期）系公司加快产能建设和产品技术升级、持续巩固国内半导体 IDM 龙头企业优势地位、把握功率半导体领域发展机遇、打造具有国际一流竞争力的综合性的半导体产品供应商这一战略发展目标而计划实施的投资项目。

项目实施主体为公司控股子公司成都士兰，募集资金将通过公司向成都士兰增资的方式投入；项目建设地点为四川省成都市成都-阿坝工业集中发展区。该项目将在现有功率模块封装生产线及配套设施的基础上，通过购置模块封装生产设备提升汽车级功率模块的产能；项目达产后，新增年产 720 万块汽车级功率模块。

2、项目实施的必要性

本项目实施的必要性具体详见本预案“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家产业政策及相关规划，属于重点鼓励建设的项目

我国“十四五”规划将半导体和集成电路列为“事关国家安全和全局的基础核心领域”，集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发以及集成电路先进工艺、IGBT 和 MEMS 等特色工艺突破都被予以重点关注。基于功率半导体产品市场的增长、新能源汽车行业需求的增加以及“缺芯”问题的急迫

性,加快国产替代化已经成为共识。国家出台产业政策大力推进产业发展和相关领域的应用,本项目的建设与中国产业规划及产业结构调整指导目录等政策文件所制定的目标相一致,符合我国产业政策的指导方向与发展要求。

(2) 功率半导体市场空间广阔,公司已具备良好的客户基础

汽车半导体封装项目(一期)项目生产产品的市场空间及客户基础具体详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“(一)年产36万片12英寸芯片生产线项目”之“3、项目实施的可行性”之“(2)功率半导体市场空间广阔,公司已具备良好的客户基础”。

(3) 公司技术、知识产权和人才储备优势明显,为项目实施提供保障

公司的技术、知识产权和人才储备优势具体详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“(一)年产36万片12英寸芯片生产线项目”之“3、项目实施的可行性”之“(3)公司技术、知识产权和人才储备优势明显,为项目实施提供保障”。

在功率器件芯片制造和功率模块封装方面,成都士兰功率模块封装团队曾承担2011年度国家科技重大专项(02专项)“高速低功耗600V多芯片高压模块”项目,该项目中“高压模块芯片制造和功率模块组件封装”课题主要研究功率模块封装用芯片制造工艺和功率模块封装工艺研发。该项目已经完成验收,公司在高压IGBT芯片以及智能功率模块设计、封装技术方面均取得了突破,且相关产品已进入量产阶段,在客户端获得优异的评价。项目团队还承担了国家工信部集成电路产业研究与开发专项资金2013年度“高压IGBT芯片工艺技术开发及产业化”项目和2015年度“功率集成模块封装(PIM)技术开发及产业化”项目,这两个项目都是关于功率模块芯片制造和封装方面的开发和产业化。通过国家级项目的实施,公司及项目团队建立了IGBT芯片、FWD芯片的研发和制造能力,也建立了IPM模块和PIM模块的研发和生产能力。截至2021年年底,公司已有约16,500万颗IPM模块广泛应用到下游家电及工业客户的变频产品上,包括空调、冰箱、洗衣机,油烟机、风扇、工业风扇、水泵、电梯门机、缝纫机、电动工具、

工业变频器等。目前，公司已具备月产7万只汽车级PIM模块的生产能力，已向比亚迪、零跑、汇川等下游厂家实现批量供货。

(4) 项目建设地产业集聚规模明显，带动成都本地产业链快速发展

随着珠三角、长三角、环渤海经济圈的产业饱和以及内陆经济的发展，中国工业向以成都为中心的西部经济圈梯度转移。四川省经济和信息化厅、省发展改革委还将牵头着力推进“设计-制造-封装测试-材料设备-信息服务”产业链一体化发展，实现集成电路与新型显示产业集聚效应，力争打造世界级产业集群。根据四川省“十四五”集成电路产业规模规划，2022年四川省集成电路产业规模达到1,500亿元，2025年达到2,000亿元，四川省集成电路产业规模主要集中在成都市。成都市成阿园区独有的“并联两地，六省援建，八方联动”的特殊背景，吸引各地区优质工业资源汇集于此，推动成阿园区成为承载产业转移的最佳选择，成为“成渝双城经济圈”中重要的一环。

该功率模块封装项目符合国家及四川省、成都市产业发展方向，项目实施后预计未来几年成都士兰的功率模块产品的生产规模将会持续扩大，对全国包括四川省、成都市下游应用企业，尤其是新能源汽车领域有极大的促进作用。同时，项目的顺利建成、实施将对汽车级功率模块应用国产化、降低产品成本、提升产品技术性能等方面有显著的提升作用。

4、项目投资计划

本项目投资总额为人民币300,000万元，其中固定资产投资285,000万元，铺底流动资金15,000万元；本项目拟投入募集资金110,000万元，全部用于固定资产投资，剩余部分由公司自筹资金投入。

5、项目建设周期

本项目工程建设期3年。

6、项目预期经济效益

本项目预计内部收益率为14.30%（税后），静态投资回收期为5.30年（含建设期），具备较好的经济效益。

7、项目涉及的审批备案进度

本募集资金投资项目已完成项目备案并已获取环评批复。

(四) 补充流动资金

1、项目概况

公司拟将本次募集资金 165,000 万元用于补充流动资金，以降低公司的资产负债率，优化资本结构，解决公司营运资金需求，满足业务持续发展需要，增强公司竞争力。

2、项目实施的必要性

公司所处的半导体行业属于技术、资本密集型行业，行业的迅速发展、技术的持续更迭离不开资金的不断投入和人才的持续输送。本次拟使用部分 165,000 万元募集资金用于补充流动资金，一方面，将为公司经营规模的扩大、持续的技术研发投入等提供充足的流动资金支持；另一方面，本次募集资金部分用于补充流动资金，能够降低公司的资产负债率，优化资本结构，提高偿债能力，改善流动性指标，降低公司财务风险与偿债压力。

3、项目实施的可行性

本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合公司所处行业相关政策和行业现状，符合公司实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行募集资金拟用于投资建设“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”、“SiC 功率器件生产线建设项目”、“汽车半导体封装项目（一期）”和补充流动资金，公司将按计划推进项目实施。本次募投项目的实施，有助于公司进一步提升汽车级功率模块等新兴产品的产能规模和销售占比，推进产品结构升级转型；有助于公司形成功率半导体领域的先发优势、规模优势和成本优势，从而增强客户服务能力和市场竞争力，持续巩固公司的国内半导体 IDM 龙头企业优势地位；有助于公司提高行业话语权和国际影响力，助力公司打造具有国际一流竞争力的综合性的半导体产品供应商的战略发展目标。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；同时将降低财务风险，提高偿债能力和抗风险能力。本次募集资金投资项目符合公司发展战略，随着募集资金投资项目的有序开展，公司未来的经营业绩和盈利能力将会得到显著提升。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

（一）本次发行后公司业务与资产是否存在整合计划

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“SiC功率器件生产线建设项目”、“汽车半导体封装项目（一期）”及补充流动资金。公司本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关，有利于提高公司核心竞争力。

本次发行完成后，公司业务及资产不存在整合计划，公司主营业务不会发生变化。

（二）本次发行后对公司章程的影响

本次发行完成后，公司将在注册资本与股本结构方面对《公司章程》进行相应修改，此外，公司无其他修改公司章程的计划。

（三）本次发行对股权结构的影响

本次发行后，公司股本总额将相应增加，公司的股东结构将发生一定变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划，公司的高管人员结构不会因本次发行而发生变化。若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的决策程序和信息披露义务。

（五）本次发行对公司业务结构的影响

公司本次向特定对象发行募集资金投资项目围绕公司发展战略布局展开,与公司主营业务高度相关。项目实施后,公司12英寸芯片、SiC功率器件与汽车半导体封装的产能将有所扩大,市场份额有望进一步提升;同时,本次募集资金投资项目投产后将有利于提高公司主营业务盈利水平,增加公司资产规模和增强抗风险能力,提升和巩固公司的行业地位,促进公司的可持续发展。

本次发行完成后,随着资金的投入和项目的实施,募集资金投资项目达产后,公司主营业务结构不会发生明显变化。

二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一) 对公司财务状况的影响

本次发行将充实公司的股权资本,公司的总资产及净资产将相应增加,资产负债率将相应下降,公司的财务结构将进一步改善;同时,募集资金投资项目产生的效益,将对财务状况起到提升作用,增强公司未来的持续经营能力。

(二) 对公司盈利能力的影响

本次发行完成后,公司净资产和总股本将有所增加,而募集资金投资项目的经济效益尚未完全体现,短期内公司的净资产收益率可能有所下降。募集资金投资项目顺利实施后,公司产品结构进一步优化,核心竞争力将明显提高,预计公司销售收入与净利润将进一步增长,盈利能力将进一步增强。

(三) 对现金流量的影响

本次发行完成后,公司筹资活动现金净流入将大幅增加。在募集资金投资项目投入建设后,预计公司投资活动现金流出也将增加。本次募集资金投资项目达产后,公司经营活动的现金流量将进一步增加。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东士兰控股及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及产生新的关联交易和同业竞争。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，亦不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行募集资金到位后公司负债比例将有所下降，资产负债结构趋于合理，公司的营运能力和抗风险能力进一步增强。

六、本次股票发行相关的风险说明

(一) 与募集资金投资项目有关的风险

1、募投项目产能消化的风险

公司所处的半导体行业属于技术、资本密集型行业，公司主营业务不仅投资规模大，而且技术壁垒高，在制造过程中需要集成物理、化学、光电、机电等多领域的知识。随着新能源汽车对功率模块需求量逐渐增大，公司持续对汽车级功率模块领域进行布局及扩产。本次募投项目投产后，公司12英寸芯片、SiC功率器件与汽车半导体封装的产能得到提升，公司将凭借在该领域的先发优势、规模优势和成本优势，顺应市场发展趋势，继续保持行业龙头地位。

尽管本次募投项目的实施符合国家产业政策和行业发展趋势，公司对本次募投项目的可行性研究是在目前客户需求、市场环境和公司技术能力等基础上进行的，但若因全球经济走势放缓、下游新能源汽车等行业增速不及预期等因素导致

项目发生开工率下降、下游客户需求不足等重大不利变化，则存在公司无法按原计划顺利实施该等募投项目，或该等募投项目的新增产能消化不及预期的风险。

2、募投项目新增折旧、摊销影响公司业绩的风险

本次募投项目建成后，每年新增折旧、摊销费用金额较大。本次募投项目投产初期，生产负荷较低，经济效益较少，新增折旧、摊销将对公司的经营业绩产生一定的影响。若本次募投项目市场环境发生重大变化或市场拓展不足，公司在折旧、摊销增加的同时，无法实现预期的投资收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）本次发行摊薄即期回报的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间，这段期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率将存在下降的风险，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。

（三）行业、技术变革与市场竞争风险

公司从事的半导体行业具有技术含量高、资金投入大等特点，行业技术快速更新换代，行业的需求和业务模式不断升级。公司自成立以来，始终重视研发投入，密切注意新技术、新市场的发展趋势，优化研发规划，使研发资源配置符合未来技术和市场发展方向。然而，半导体行业发展变化非常迅速，如果公司在行业和技术发展方向上出现误判或者技术投入不足，可能造成产品丧失竞争优势、现有核心技术被竞争对手模仿等风险。

公司作为以IDM模式为主要经营模式的综合性半导体产品企业，多年来持续加大研发投入，未来将通过积极提升生产工艺和技术装备的水平，保证所生产经营产品的技术水平的先进性，稳步提高国内外市场份额，持续优化客户结构。

（四）订单不及预期风险

受国家政策拉动、消费升级、“国产替代”效应等多方面因素影响，目前国内芯片市场需求较为强劲，公司各生产线的产能处于偏紧的状态。对此，公司正在加快年产36万片12英寸芯片、SiC功率器件与汽车半导体封装等产线建设，并积极调整产品结构，加快产品在大客户端的上量。

半导体芯片行业受宏观经济周期影响较大，如果地缘政治紧张局势不能得到有效缓解，以及随着全球通胀预期进一步提高、对全球经济有重要影响的主要经济体央行加快加息步骤等，都将对人们的消费预期产生不利影响，进而拖累全球经济。如果下游企业订单需求减少，可能会对公司产品出货造成负面影响。

新能源汽车是公司本次募投项目产品的重要下游应用领域，近年来在国家政策的大力支持下快速发展，若新能源汽车产业无法通过技术进步等方式提高行业整体的竞争力，则对其产业链的发展可能会有不利的影响，从而导致汽车半导体市场需求下降，对公司业绩带来不利影响。

（五）供应链风险

近年来，全球半导体制造业投资力度持续加大，发展速度不断加快，投产运营和在建生产线数量不断增加，半导体设备与半导体材料厂商由于需求的快速增加，可能存在实际设备与材料的产能供应无法满足市场需求的风险。

目前，公司相关产线建设涉及的部分关键设备（比如光刻机、离子注入机等）及设备备件依赖从境外采购获得；同时，公司部分关键原辅材料（比如硅片、特气等）亦依赖从境外采购获得。未来，如若公司半导体设备与材料供应商出现产能不足等情况，可能会对公司设备、备件及原辅材料的采购造成影响，进而对公司的项目建设和生产运营带来不利影响。

（六）宏观经济波动风险

公司作为以IDM模式为主要经营模式的综合性半导体产品企业，主要产品应用于电子、家电、通讯和汽车等领域，下游行业渗透于国民经济的各个领域并且受宏观经济波动的影响较大。因此，宏观经济及下游行业经济周期的不利变化会对半导体行业产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

(七) 汇率波动风险

公司从境外采购设备、备件和原辅材料的过程中需要使用较大数额的外汇，因此公司生产经营中面临一定的汇率波动风险。未来，如果人民币汇率对美元贬值幅度加大，将直接增加公司的进口采购成本，进而增加公司的项目建设成本和生产运营成本，对公司的项目建设及盈利能力带来一定不利影响。

(八) 股价波动风险

股价的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济、政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。由于以上多种不确定因素的存在，公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，存在股价波动的风险。

(九) 审批风险

本次向特定对象发行尚需经上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。公司向士兰明镓增资事宜，尚需履行国有企业增资相关审批程序。上述呈报事项能否获得相关批准或同意注册，以及获得相关批准或同意注册的时间，均存在不确定性，因此，本次向特定对象发行存在审批风险。

(十) 发行风险

本次向特定对象发行的发行结果将受到宏观经济和行业整体状况、证券市场整体情况和公司股票价格走势、投资者对本次发行方案认可程度等内外部因素影响。因此，本次向特定对象发行存在募集资金不足甚至无法实施的风险。

第四节 公司利润分配政策及相关情况的说明

一、利润分配政策

为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，在《公司章程》对利润分配政策规定进行了约定，主要内容如下：

“第一百七十二条 公司利润分配原则、形式、发放条件和时间间隔：

（一）利润分配原则

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金股票相结合等法律许可的方式分配利润。在条件许可的情况下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（三）发放股票股利的具体条件

- 1、公司未分配利润为正数且当期可供分配利润为正数；
- 2、公司董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益。

（四）利润分配时间间隔

公司可以每年度进行一次利润分配。根据公司实际情况也可以进行中期利润

分配。

第一百七十三条 公司的利润分配决策程序：

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况和资金需求提出合理的分红建议和预案，并由董事会审议后形成年度利润分配方案提交股东大会，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（比如召开网上业绩说明会等形式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。如报告期内盈利，但公司董事会未提出现金分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）股东大会应依法合规的对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分配方案的，需由公司董事会审议通过后提交公司股东大会，并经由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。对于有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会过半数的董事，并经三分之二以上独立董事审议通过后提交公司股东大会批准。

第一百七十四条 公司现金分红的条件和比例：

1、在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数，且没有重大投资或重大现金支出计划的情况下，公司应当进行现金分红。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司当年盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况

（一）最近三年公司利润分配情况

1、2019年年度利润分配情况

2019年度利润分配以方案实施前的公司总股本1,312,061,614股为基数，每股派发现金红利0.005元（含税），共计派发现金红利6,560,308.07元。公司2020年6月5日召开的2019年年度股东大会审议通过了以上利润分配方案，并已于

2020年7月8日实施完毕。

2、2020年年度利润分配情况

2020年度利润分配以方案实施前的公司总股本1,312,061,614股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利20,992,985.82元。公司2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过了以上利润分配方案，并已于2021年6月18日实施完毕。

3、2021年年度利润分配情况

2021年度利润分配以方案实施前的公司总股本1,416,071,845股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利141,607,184.50元。公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了以上利润分配方案，并已于2022年7月13日实施完毕。

（二）最近三年现金分红情况

公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾成长与发展，最近三年以现金方式累计分配的利润为16,916.05万元，占最近三年实现的年均可分配利润的31.72%，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
归属于上市公司股东的净利润	151,772.56	6,759.72	1,453.20
现金分红金额（含税）	14,160.72	2,099.30	656.03
现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的比例	9.33%	31.06%	45.14%
最近三年累计现金分红金额（含税）	16,916.05		
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润	53,328.50		
最近三年累计现金分红金额占归属于上市公司股东的年均净利润的比例	31.72%		

（三）最近三年未分配利润使用情况

最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金后及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，作为公司业务发展

资金的一部分,主要用于公司的日常经营等用途,以支持公司的长期可持续发展。

三、未来股东回报规划

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监管机制,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,给予投资者合理的投资回报,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及要求,同时结合公司实际情况,公司第七届董事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《股东分红三年(2021-2023)回报规划》,主要内容如下:

“第一条 公司制定规划考虑的因素

公司应以企业长期的、稳定的、可持续的发展为基本立足点,综合考虑各方股东的利益诉求、外部宏观经济环境、社会资金成本,结合企业自身经营发展战略、目前及未来盈利能力、现金流情况、项目投融资安排和获取资金的综合成本,以期对投资者有持续的合理回报。因而公司对利润分配做出了制度性安排,以期保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 规划的制定原则

公司董事会根据章程确定的利润分配政策制订本规划。

公司董事会将根据当期的经营情况和未来项目投资的资金需求情况,在充分考虑各方股东利益的基础上妥善处理公司的长远发展和短期利益的关系,确定合理的利润分配方案。

第三条 规划的制定周期和相关决策机制

公司董事会应当根据公司章程确定的利润分配政策,制订股东分红回报规划,至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划。如公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,或因监管部门修改分红政策的相关法律法规及其他规范性文件而需要调整利润分配政策的,董事会应当结合股东特别是中小股东的

意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定适应当时情况的股东分红回报规划，并报相应股东大会审议批准。

第四条 公司未来的股东回报规划

1、利润分配的原则

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、公司同时满足下列条件的应当实施现金分红：

- (1) 在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数；
- (2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资(包括新开项目投资、以前年度延续项目)、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5 亿元人民币；公司未来十二个月内，一次性偿还债务达到或超出公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5 亿元人民币。

3、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

4、公司利润分配的最低分红比例

公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

5、利润分配的时间间隔：符合公司章程规定的条件，公司可以每年度进行一次利润分配。根据公司实际情况也可以进行中期利润分配。

6、利润分配方案的制定及执行：

(1) 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况和资金需求提出合理的分红建议和预案,并由董事会审议后形成年度利润分配方案提交股东大会,公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。如报告期内盈利,但公司董事会未提出现金分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 股东大会应依法合规的对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分配方案的,需由公司董事会审议通过后提交公司股东大会,并经由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(3) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(4) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

(5) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。对于有关调整利润分配政策的议案,需经公司董事会半数以上董事,并经三分之二以上独立董事审议通过后提交公司股东大会批准。”

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司未来 12 个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、本次发行摊薄即期回报的有关事项

(一) 本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

1、测算假设和前提条件

(1) 假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

(2) 假设本次向特定对象发行于 2023 年 6 月底完成，该预测时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终完成时间以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后公司实际发行完成时间为准。

(3) 假设本次发行股数为目前公司股本的 20%，即 283,214,369 股，募集资金总额为 650,000.00 万元（不考虑发行费用的影响）。

(4) 在预测公司总股本时，以本报告公告日的总股本 1,416,071,845 股为基础，2023 年的股本变动情况仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑可能发生的股票股利分配、股权激励、股份回购等其他因素导致股本发生的变化。

(5) 公司 2022 年年报尚未披露。根据公司《2022 年第三季度报告》，公司 2022 年 1-9 月实现的归属于上市公司股东的净利润为 77,438.86 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 67,002.72 万元，假设公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润

均为公司 2022 年 1-9 月已实现的相应指标乘 4/3。假设公司 2023 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与 2022 年持平、增长 10%、增长 20%。

(6) 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对未来经营情况及趋势的判断, 亦不构成公司盈利预测: 公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响, 存在不确定性: 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设, 本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2022 年度	2023 年度	
	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
总股本(万股)	141,607.18	141,607.18	169,928.62
假设情形一: 公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较 2022 年持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	103,251.81	103,251.81	103,251.81
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	89,336.96	89,336.96	89,336.96
基本每股收益(元/股)	0.73	0.73	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.57
假设情形二: 公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较 2022 年增长 10%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	103,251.81	113,577.00	113,577.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	89,336.96	98,270.66	98,270.66
基本每股收益(元/股)	0.73	0.80	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.69	0.63
假设情形三: 公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司			

股东的净利润均较 2022 年增长 20%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	103,251.81	123,902.18	123,902.18
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	89,336.96	107,204.35	107,204.35
基本每股收益（元/股）	0.73	0.87	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.63	0.76	0.69

注：基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定测算。

3、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会增加。由于募集资金投资项目实施和产生预期经济效益需要一定的时间，短期内公司每股收益将出现一定程度的下降。本次募投项目达产后，公司的营业收入和净利润将有所增加。随着募投项目效益的释放，将逐步提升公司的盈利能力，增加公司每股收益，优化公司的各项财务指标。

特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

（二）本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。本次发行的必要性与合理性请参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行募集资金拟用于投资建设“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”、“SiC 功率器件生产线建设项目”、“汽车半导体封装项目（一期）”和补充流动资金。本次募集资金投资项目的实施有助于公司加快产能建设和产品

技术升级、持续巩固国内半导体 IDM 龙头企业优势地位、把握汽车功率半导体领域发展机遇。本次发行后，公司的业务范围保持不变。

2、人员、技术、市场等方面的储备情况

公司拥有人员、技术、市场等方面的储备，确保本次募投项目顺利实施。具体详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”中的“（一）年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”之“3、项目实施的可行性”之“（3）公司技术、知识产权和人才储备优势明显，为项目实施提供保障”以及“（二）SiC 功率器件生产线建设项目”之“3、项目实施的可行性”之“（3）公司技术、知识产权和人才储备优势明显，为项目实施提供保障”以及“（三）汽车半导体封装项目（一期）”之“3、项目实施的可行性”之“（3）公司技术、知识产权和人才储备优势明显，为项目实施提供保障”。

（四）填补回报的具体措施

为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金合理使用，同时有效防范即期回报被摊薄的风险，具体的措施包括：

1、深入实施公司发展战略，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益

公司将抓住集成电路行业的发展机遇，继续推进公司在功率半导体领域的战略规划，进一步拓展公司汽车级功率模块应用产品的产能，提升市场份额。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目是基于国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举措。本次募集资金到位后，公司将及时推进募集资金投资项目实施，高效地完成募集资金投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目早日实施并实现预期效益。

2、严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理，规范募集资金的使用

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，公司制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户，公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规定，对募集资金的存储和使用进行规范管理，确保募集资金合理使用，有效防范募集资金使用风险。

3、不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

同时，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

(五) 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司的董事和高级管理人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(六) 公司控股股东、实际控制人出具的承诺

根据中国证监会相关规定，为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023年2月24日